

创业邦获悉，苏州科阳半导体有限公司完成超5亿元融资，本轮融资由中芯聚源、临芯资本领投，同时有镇江国控、财通创新、鼎晖投资等知名投资机构，苏州本地资本如中鑫资本、致道、姑苏人才二期（苏州资管）、康力君卓（君子兰资本）、跃麟创投（苏州基金）、环秀湖壹号（高铁新城直投）、东吴创投等鼎力加入，龙驹资本持续加码。本轮融资款项，将用于科阳半导体先进封装项目建设、持续扩产、运营以及相关技术产品研发的持续投入。

苏州科阳半导体有限公司，是一家专业从事晶圆级封装测试服务的高新技术企业，目前注册资本4.5505亿元。公司于2013年开始筹建，2014年正式量产，目前总投资近10亿元，总占地面积约70亩。

其专注于先进封测技术的研发量产，拥有8吋和12吋晶圆级封装产品线，具有TSV、WLCSP、Bumping等多种封装能力，年产30亿颗芯片。CIS传感器、5G滤波器芯片产品可广泛应用于汽车电子、工业、5G通讯和IoT等领域。申请专利174件，获得25件发明专利和72件实用新型专利授权，注册商标14件。

作为一家在市场、客户和团队紧密合作下有机成长起来的本土企业，科阳专注于以TSV技术为基础的先进封装领域近10年，一直在为行业头部客户提供专业、优质的服务，是全球三家专业TSV厂商之一。

科阳半导体董事长兼CEO李永智表示：“通过本轮增资，科阳进一步优化了股权结构，加强了资金实力，同时，充分激发和释放了团队的积极性和创造力，为科阳进一步深耕先进封装领域奠定了坚实的基础。”

本轮领投方之一中芯聚源合伙人赵森表示：“本次增资混改完成后，科阳将进一步扩大研发投入以及推进12吋线的建设，在CIS和滤波器先进封装赛道中快速发展，并迎来新的爆发期，有望发展成为领先的先进封装服务商之一。”

本轮领投方之一临芯投资董事长李亚军表示：“科阳8吋CIS TSV封装在国内已有非常重要的地位，12吋产线也已跑通，滤波器封装线正在为国内知名大厂批量供货，未来还有更多的先进封装技术研发。”

据悉，未来科阳将以技术创新为驱动，继续加大产品研发和市场投入，进一步整合产业链上下游资源，推进12吋TSV车规线及高端车规CIS封装，Saw、Baw、F-bar等全系列滤波器封装测试，及其他3D封装方式，形成传感器和射频特色封测产业布局，积极携手产业上下游、专业投资机构等合作伙伴，共同构建半导体行业国产化新局面。附